ウシオ電機株式会社 2024 年（令和 6 年）3 月期 第 4 四半期決算・新成長戦略説明会

主な質問と回答

日時：2024 年 5 月 14 日（火）18:15 ~ 19:30

方式：オンライン

説明者：代表取締役社長 兼執行役員社長 CEO 朝日 崇文

＜ご留意事項＞「主な質問と回答」は、決算説明会に出席されなかった方々のために、参考として掲載しています。掲載する内容は、当社の判断で簡潔にまとめたものであることをご了承ください。また、本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があることをご了承ください。

◆ 質問者：モルガン・スタンレー-MUFG 証券 和田木様

Q：この 10 年、成長ドライバー不在という厳しい状況が続き、本日の説明でもアプライドマテリアルズ社（以下、AMAT 社）との業務提携によるデジタルリソグラフィ装置以外、具体的なドライバーが見えてきませんが、しばらくは、このデジタルリソグラフィ装置頼りの状況になるのでしょうか。それとも、Phase II になると何か新しい成長ドライバーが見えてくるのでしょうか？現状、言える範囲で教えてください。

A：成長ドライバーという意味では、AMAT 社との業務提携によるデジタルリソグラフィ装置は、重要な位置づけにあります。また、現状のステッパー露光装置やアドテックエンジニアリングのダイレクトイメージング（以下 DI）露光装置についても、アドバンスドパッケージ市場向けの開発を加速させています。今後アドバンスドパッケージ市場は、確実に拡大していくとの認識のもとで取り組んでおり、今後の成長において大きな柱となります。

それ以外では、半導体製造のプロセス向けで、特に加熱プロセス向けの光源開発に注力しており、成長ドライバーの一つになっていくと考えています。更に、もう少し先の話としては、検査・分析分野で、例えば、昨年に電子線に関する協業等を発表していますが、既存光源も含め、光源の開発を進めることで、この分野への展開も新たな成長ドライバーとなっていくと考えています。したがって、これら Industrial Process 分野の幅広い、特に半導体を中心としたマーケット向けが次の成長ドライバーと考え進めています。

Q：半導体アドバンスドパッケージで、今後、基板がガラスになるとサプライチェーンも大きく変わり、貴社にもチャンスがあるのではと思っておりますが、ガラス基板に対する取り組みについて、可能な範囲で教えてください。

A：ガラスも含め新素材をカバーできるようラインアップの強化を進めています。アドバンスドパッケージ領域の中で、様々な方式が進んでおり、それらをカバーできるように進めています。

Q：貴社の 20 年来の課題として、営業力やマーケティング力の欠如がありますが、AMAT 社とのデジタルリソグラフィ装置の展開にあたって、この辺の強化をどう考えていますか。また、EUV 光源については、他社光源の台頭が問題ではなくて、貴社自身の光源に問題があったのではと考えていますが、この辺の認識についてお伺いできますか。

A：営業力については、今回、AMAT 社ともさまざまなディスカッションをしながら、効率よく営業活動などができるよう進めています。Tier1（半導体メーカー大手）では、AMAT 社が強い関係性を持っており、私達も AMAT 社と一緒に取り組みを進めているところです。また、Tier2（パッケージ専門の基板メーカーや OSAT など）では、ウシオ電機が非常に強い販売力、サービス網を持っており、これらを融合させながら、強く推し進めていく考えです。また、人財などのリソースについても、従来のように分散させずに、社内でのリスクリングも含め営業力、カスタマーサポート力強化を全社的に取り組んでいます。

EUV 光源については、コスト面で私達の取り組みに大きな反省があり、他社光源の台頭を許してしまった点は真摯に反省し、その巻き返しに向け、現在、お客様含めいろいろと検討と開発を進めている状況です。

◆ **質問者：ジェフリーズ証券 中名生様**

Q：AMAT 社とのデジタルリソグラフィ装置ですが、2026 年度及び 2030 年度でどのくらいの業績寄与がありますか。また、どのくらいのタイミングで製品が上市される予定でしょうか。

A：業績への貢献タイミングは、Phase I の最終年度（FY26）辺りからとなり、それに向けて着々と進めているところです。その後は、高い成長率で拡大していく計画です。具体的な貢献金額などは申し上げられないですが、アドバンスドパッケージ市場で半分程度のシェア獲得を目指しており、ある程度の自信をもって計画しています。アドバンスドパッケージ分野向けでは、既存のウシオ電機のステッパー露光装置やアドテックエンジニアリングの DI 露光装置なども貢献していく計画ですが、大きな成長ドライバーは AMAT 社との共同開発によるデジタルリソグラフィ装置が牽引するものと考えています。

Q：アドバンスドパッケージ関連の露光装置が CAGR15%以上で伸び、2030 年には関連する露光装置の半分程度が AMAT 社とのデジタルリソグラフィ装置が占めることになるのでしょうか。

A：2030 年には同分野の半分程度のシェアを取っていく考えで、既存のステッパー露光装置や DI 露光装置による貢献もありますが、デジタルリソグラフィ装置が非常に速いスピードで成長し、その結果、2030 年には半分以上のシェアを占めることになると考えています。

Q：AMAT 社に関して、今期（FY24）で 13 億円の投資計画とのことですが、今後 3 年間も同規模の投資が続くと考えてよろしいでしょうか。

A：一定程度の開発費が継続します。今後のボリューム次第で更に開発費は増えていく方向にはなりますが、それ以上の収益をもたらす計画です。

Q：半導体加熱用途の光源ですが、どのような装置向けで、どのくらいの話が進展しているのでしょうか？ 貴社は加熱用の光源を供給するというビジネスモデルになるのでしょうか。

A：お客様との関係で具体的には申し上げられませんが、さまざまなお客様と話を進めており、半導体の前処理のウエハ表面を瞬時に加熱するなど、さまざまな用途での加熱光源のニーズがあり、フラッシュランプやハロゲンランプ、及び LED などの光源をその用途に合わせ提案し進めています。

Q：Visual Imaging 事業は、今後 3 年間で売上が減る計画ですが、シネマは、これから買い替え需要もあり、成長する分野であると思っています。なぜ 3 年後の売上は減ってしまうのでしょうか。

A：同事業において、規模拡大より高付加価値な分野に注力していく考えで進めていく方針です。可能性として売上が増加していくこともあり得ますが、収益率の改善を主軸においた施策を進めていく考えです。

◆ **質問者：SBI証券 氏原様**

Q：半導体アドバンスドパッケージ市場でのプレゼンス拡大の際に、顧客層の広がりによる安定した売上基盤構築を計画されていますが、新たにデジタルリソグラフィ装置が加わることで、従来の主要顧客層への依存が解消し、顧客層の拡大が見込めるとの点について、例えば、2ミクロン以下のL/S、すなわち最先端のパッケージ基板向け露光装置での貴社のプレゼンスが上がるということであれば、それをできる顧客は既存の基板メーカーが中心となり、貴社にとっての主要顧客は、逆に絞り込まれるのではないかと考えています。最先端の製品を持つことで、少し下流の顧客層にも広げていくとの意味合いがあるのでしょうか。

A：既存のウシオ電機の顧客層から、さらに拡大していくと考えています。今回、デジタルリソグラフィ装置をラインアップに加えることで、ローエンドからハイエンドまで幅広いラインアップ化が実現し、例えば、半導体メーカーに繋がる方々と開発をしている顧客層に対し、さまざまプロジェクトに沿った投資計画に対応できる提案が可能になるなど、幅広い顧客とお付き合いができるようになると考えています。

Q：従来のウシオのステッパー露光装置やアドテックエンジニアリングのDI露光装置なども含め、主要な半導体メーカーに直結する一連のサプライチェーン全体に入り込める可能性があるということでしょうか。

A：その通りです。デジタルリソグラフィ装置が牽引しつつ、既存だけでなく次世代のステッパー露光装置やDI露光装置も合わせ、その可能性があると考えています。

◆ 質問者：野村證券 吉岡様

Q： EUV 関連で、3 カ月前から足元で、前向きになれる要素は出てきていますか。また、将来的に事業性が見込めない場合、撤退などを検討するとのことですが、撤退を検討する条件として、具体的にどうなれば、そのような検討が進むのでしょうか。

A： 営業機密により、明確に回答できませんが、現在、お客様と High-NA 分野に向け取り組みを進めており、進捗しています。ただし、求められるスペックが高いレベルにあり、まずはその部分のしっかりと対応しないといけない状況です。なお、特定用途以外にも、検査用途などいくつか新しい用途で可能性が出てきており、引き合い等々があります。市場性や求められるスペック等々を比較しながら、検討を進めている状況です。

事業性の判断については、例えば、High-NA 領域でスペックがマーケットで求められるレベルに達することができない場合は、撤退などを検討しますが、この辺りはまだ色々な選択肢があり得ます。市場性と事業性、収益状況を鑑みながら、厳格に判断し、将来的な企業価値を生む事業であるという確信のもと、進めていく方針であり、そこに至らなければ撤退をしていくと考えです。

Q： 半導体アドバンスドパッケージ分野で、今後、SAM（対象市場）も広がり、シェアも上げていくストーリーですが、足元の SAM や貴社のシェアは、どのくらいのイメージですか。今後、シェアを広げていく際に、どのような顧客層を狙っていくのでしょうか。

A： 半導体アドバンスドパッケージ分野では、2025 年度でシェア 20%を計画していますが、パッケージの構造により、私達の露光装置の得意な部分とそうでない部分があり、足元は、私達が得意としている部分で需要が厳しい状況にあります。ただし、今後は、半導体メーカーとのバリューチェーンのつながりの中でシェアが拡大していくと考えています。特に今後は、最先端のパッケージ開発を、各社とも取り組んでいくと思いますので、それにしっかり対応していくことで、シェアを拡大していきたいと考えています。

以上